## S602 CIP 法によるレーザーアプレーション過程のシミュレーション

Simulation of Laser Ablation Process by CIP Method 矢部孝

大叩子

## 東工大 機械物理 Takashi Yabe Tokyo Institute of Technology

ナノ秒からミリ秒までの、レーザー加工のシミュレーションに関しては、色々なところで解説を書 いてきた。ここでは、この計算コードが果たしてフェムト秒レ

ーザーでも使えるかどうかを調べた結果のみを示す。

まずは、フォッカー・プランク方程式を CIP 法で解くこ とによって、フェムト秒レーザーの吸収過程を調べた。図 1(下) は、固体の表面にレーザーを照射した後での電子の熱流と温度 である。これを、縦軸を熱流、横軸を温度勾配として、図 1(上) にまとめた。固体側では、熱流と温度の関係は比例しており、 実線の古典理論(フーリエ則、Spitzer-Harm 理論)に一致して いる。一方、真空側では、熱流は温度勾配によらない、自由流 となっている。驚くべきことに、ほとんどパルス幅と同程度の 時間で古典的な熱伝導が実現している。この時点では、流体(イ オン)は全く動いていない。

従って、穴が形成されるのはこれよりもはるか後の段階で ある。しかも、このシミュレーションの示すとおり、この後の 過程は古典的な熱伝導理論で十分である。

実際に、この古典的な流体シミュレーションが実験を再現 することができるかどうかを調べてみよう。その前に、実験を よく吟味する必要がある。図2(左)のは実験データであるが、 レーザーの集光径がわからないので、ドイツのグループは、照 射痕から集光径を見積もってFluenceを求めた。

図2(右)はレーザーの集光径と照射痕との関係をシミュ レーションから求めたものである。フェムト秒レーザーといえ ども、倍以上ものずれが生じている。従って、実験を「解釈」 するときに、これをちゃんと議論しなければ意味がない。

シミュレーションでこのようにして求めた照射痕を用いて、 Fluenceを補正した(実験と同様 に)結果が図2(左)のである。 一方、本当の集光径から見積もったFluenceでデータを整理する とシミュレーション結果は、図の 破線ように大きくずれる。ドイツ のグループは、穴の深さの Fluence依存性を議論し、熱伝 導になる前の色々な物理過程 を提案しているが、実際には、 Fluenceの見積もりが違っていただけの話である。  $\log(T/\nabla T/\lambda_{fre})$ 



図1 フォッカープランクコードによ リ、フェムト秒レーザー照射後の電子 の挙動をシミュレーションした。(下) 温度と熱流空間分布(上)縦軸は熱 流で横軸は温度の空間スケール。極め て短い時間で、固体側の熱流は古典的 な熱伝導(実線)に近づく。



図2 (左)流体シミュレーションを用いて、レーザー強度とアブレーション深さを比較。白丸がシミュレーションで実験は黒四角。実験は、照射 痕から Fluence を見積もったが、シミュレーションもこれと同様にした。こ れとは別に、レーザー集光径で Fluence を出すと、破線のようになる。フェ ムト秒といえども、集光径と照射痕が大きく異なることを指摘した。(右) レーザー集光径に対する照射痕。シミュレーション(記号)は、照射痕が かなり大きくなることを示している。破線は、照射痕と集光径が一致する 線。